

PROGRAMME DE VALIDATION DES PROCÉDÉS DE FABRICATION SANS PLOMB DES CIRCUITS ÉLECTRONIQUES.

Le 1^{er} novembre 2005, le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et le [Regroupement de l'industrie électronique](#) (RIE) ont profité du lancement du [Bureau d'aiguillage au sans plomb \(BASP\)](#) pour signer une première entente de collaboration. L'entente porte sur un projet de recherche dont l'objectif est de développer un programme de validation des procédés de fabrication sans plomb des circuits électroniques.

Cette initiative du CRIQ s'inscrit dans une démarche orchestrée de tous les intervenants du milieu qui vise à accélérer l'adaptation de l'industrie électronique afin de lui permettre de rencontrer l'échéancier de juillet 2006 fixé par l'Europe, pour se conformer à la [directive](#) concernant les substances dangereuses.

Parmi les entreprises qui ont accepté de participer au projet, on retrouve, entre autres : Circuits imprimés de la Capitale, Circuits Technologies Avro 2001, Conception Technique, Électronique S.E.M., Fiso Technologies, Gecko électronique, Labo Circuits, M2S, Olympus NDT Canada et Produits nationaux pour l'environnement.



MM. Gilles Duchesne du RIE et Serge Guérin du CRIQ